

2023年12月4日

報道関係者 各位

会社名 レーザーテック株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 岡林 理  
(コード:6920 東証プライム市場)  
発表担当 取締役執行役員 三澤 祐太郎  
(TEL.045-478-7111)

## 新製品 ビア深さ測定装置 VIANCA シリーズを発表

### 【概要】

この度レーザーテックは、次世代プロセスで必要とされる高アスペクトレシオ小径ビアのエッチング深さの高精度な測定を可能にした「ビア深さ測定装置 VIANCA シリーズ」を製品化いたしました。

### 【内容】

AI 技術の発展に伴いより高性能な GPU が必要とされる中、GPU に搭載される HBM(広帯域メモリ)にも高性能化と小型化が求められており、HBM 製造時に用いられる TSV(シリコン貫通電極)技術のさらなる小径化と高アスペクト化が大きな課題になっています。

VIANCA シリーズでは弊社独自の光学系により、従来の光学系では測定不可能であった高アスペクトレシオ小径ビアの深さ測定を実現し、Cu 配線後の Cu 高さ測定等、HBM 製造工程における重要な品質管理項目を高精度に測定することを可能にしました。

当社は今後もお客さまのニーズに応え、先端半導体プロセスの品質改善と歩留まり向上に貢献してまいります。

### 【特長】

- ・ 独自の光学系による、高アスペクトレシオ小径ビアの深さ測定
- ・ 次世代 TSV 形状に対応可能

### 【用途】

- ・ ビアエッチング後の深さ測定
- ・ ハイブリッドボンディングにおける Cu リセス量管理
- ・ Cu 頭出し後やバンプ形成工程における高さ測定



ビア深さ測定装置 VIANCA シリーズ

**お問い合わせ先**

〒222-8552 横浜市港北区新横浜 2-10-1

レーザーテック株式会社 第2ソリューションセールス部 上菌 秀正

TEL: 045-478-7337

E-mail: [sales@lasertec.co.jp](mailto:sales@lasertec.co.jp)